

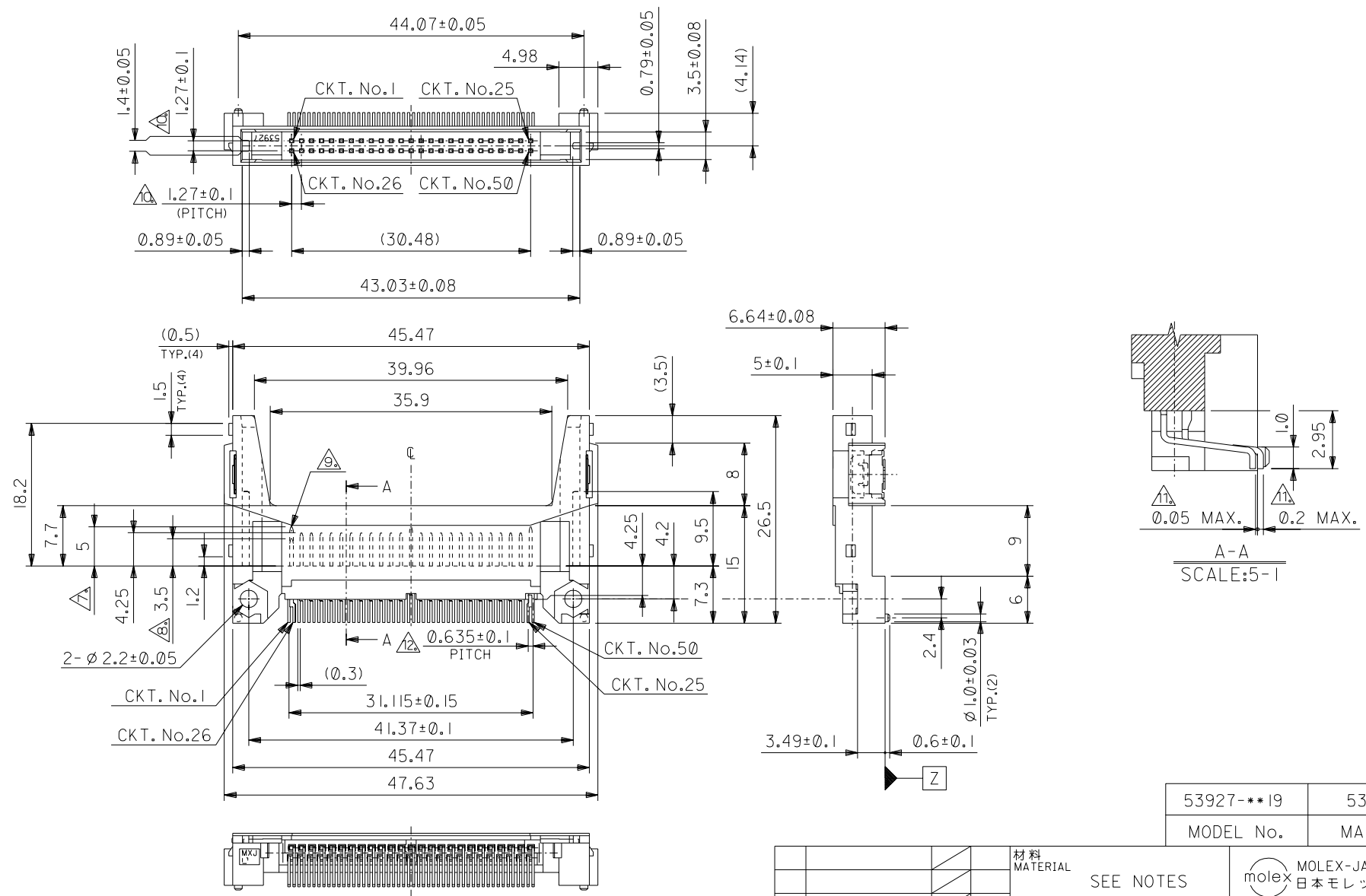
DWG. NO.
SD-53927-001

E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A



53927-**19	53927-5019
MODEL No.	MATERIAL No.

材料 MATERIAL		SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		SEE NOTES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —	TITLE 名称 CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		— # —	DWG. NO. SHEET 1 OF 2 REV	
DRAWN BY '04/05/17 T.UENO		CHK'D BY '04/05/17 M.SASAO	SD-53927-001 0	
APP'D. BY '04/05/17 M.SASAO		尺 度 SCALE 2 - 1		
角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$	記号 LTR	新規格作成 RELEASED (J2004-4268)	DR. CHK. DATE
30以上 OVER	± 0.3			
10以上 OVER 30未滿 UNDER	± 0.25			
未滿 10 UNDER	± 0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES				

DWG. NO. SD-53927-001

E

D

C

B

A

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

注)
 NOTES 1. 材質
 MATERIAL
 ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0
 HOUSING: LCP G.F. UL94V-0
 ピン：リン青銅
 PIN: PHOSPHOR BRONZE
 ネール：リン青銅
 NAIL: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様
 PLATING
 PIN 接点部：パラジウムニッケル下地、金メッキ
 CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni
 半田付け部：錫メッキ
 SOLDER TAIL AREA: TIN
 下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

NAIL 錫メッキ
 TIN
 下地メッキ：ニッケルメッキ
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

3. 推奨基板厚：t0.8 MIN.
 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t0.8 MIN.

4. 適合カード厚
 RECOMMENDED CARD THICKNESS
 接続部：3.3±0.1
 CONNECTING AREA: 3.3±0.1

5. 適合カード幅：42.8±0.1
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1

6. ハウジング色：白
 HOUSING COLOR: WHITE

△7 寸法適用極：1,13,38,50
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS
 1,13,38 AND 50.

△8 寸法適用極：25,26
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.

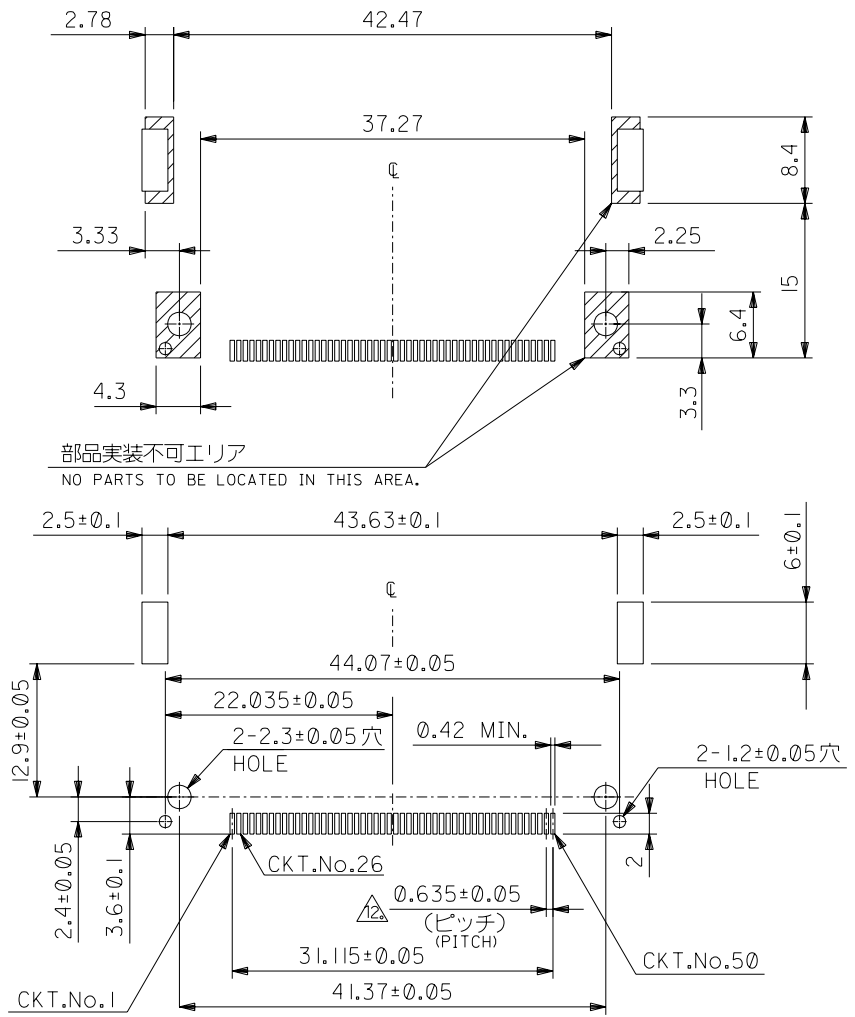
△9 ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ0.1 MAX.とする。
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1
 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.

△10 ピン根元に適用する。
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.

△11 ソルダータールは、Z面を基準とし上へ0.05下へ0.2の範囲にあり、
 且つソルダータールの平坦度は、0.15 MAX.とし、テール先端にて測定する。
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.15.
 MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.

△12 公差非累積
 NON-CUMULATIVE

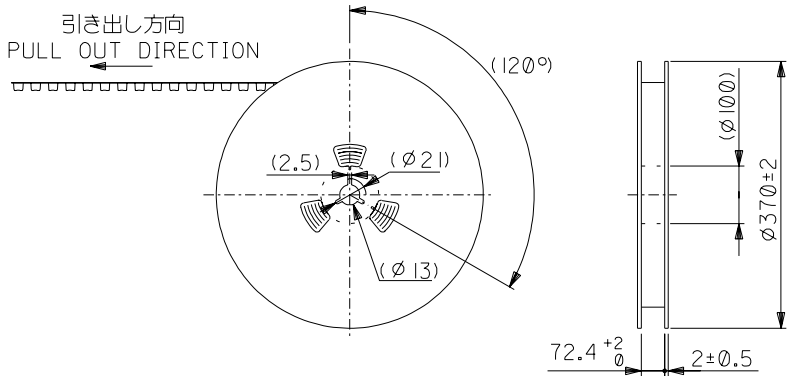
13. 本製品は 53927-**10 の鉛フリー一品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927-**10.



基板推奨寸法
 RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

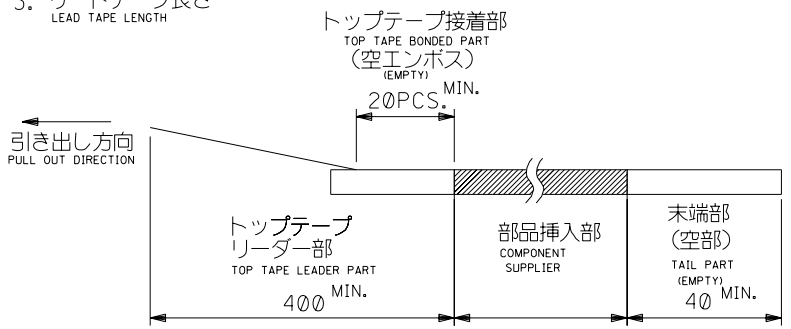
				↑		材料 MATERIAL		— # —		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH		— # —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —		TITLE 名称	
						被覆外径 INS. RANGE		— # —		CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE-	
角度 ANGLE		±3°				DRAWN BY 04/05/17		CHK'D BY 04/05/17		DWG. NO. SHEET 2 OF 2 REV	
30以上 OVER		+0.3				T.UJENO		M.SASAO		SD-53927-001 0	
10以上 OVER 30 UNDER		+0.25				APP'D BY 04/05/17		M.SASAO		SCALE 2 - 1	
10 UNDER		+0.2		0 SEE SHEET 1 OF 2		DR. CHK. 日付 DATE					
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE					

SD-53927-001.502



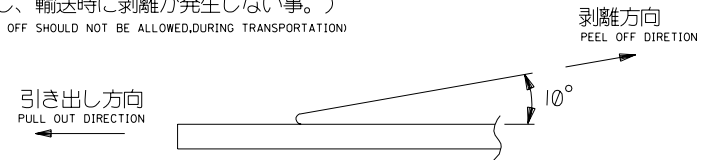
注) NOTES

- 製品番号 53927-5019 の詳細寸法については、SD-53927-001 を参照下さい。
IN THE PACKAGE , PART NO. 53927-5019 DETAILED DIMENSIONS , SEE SD-53927-001
- 梱包数量 : 280 個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 280 PCS/REEL
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
0. 1~1. 3N {10~130gf} : キャリアテープ幅 72mm
CARRIER TAPE WIDTH 72mm

尚、本規格値は、出荷時に適用。
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
(PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION)



- 材料
MATERIAL
キャリアテープ : ポリプロピレン (PP)
CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE (PP)
トップテープ : PET, PE, PEF
TOP TAPE : PET, PE, PEF
リール : 紙
REEL : CARD BOARD

- 本製品は 53927- ** 18 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927- ** 18.

53927- ** 78	53927-5078	50
MODEL NO.	MATERIAL NO.	種数 NO. OF CKTS.

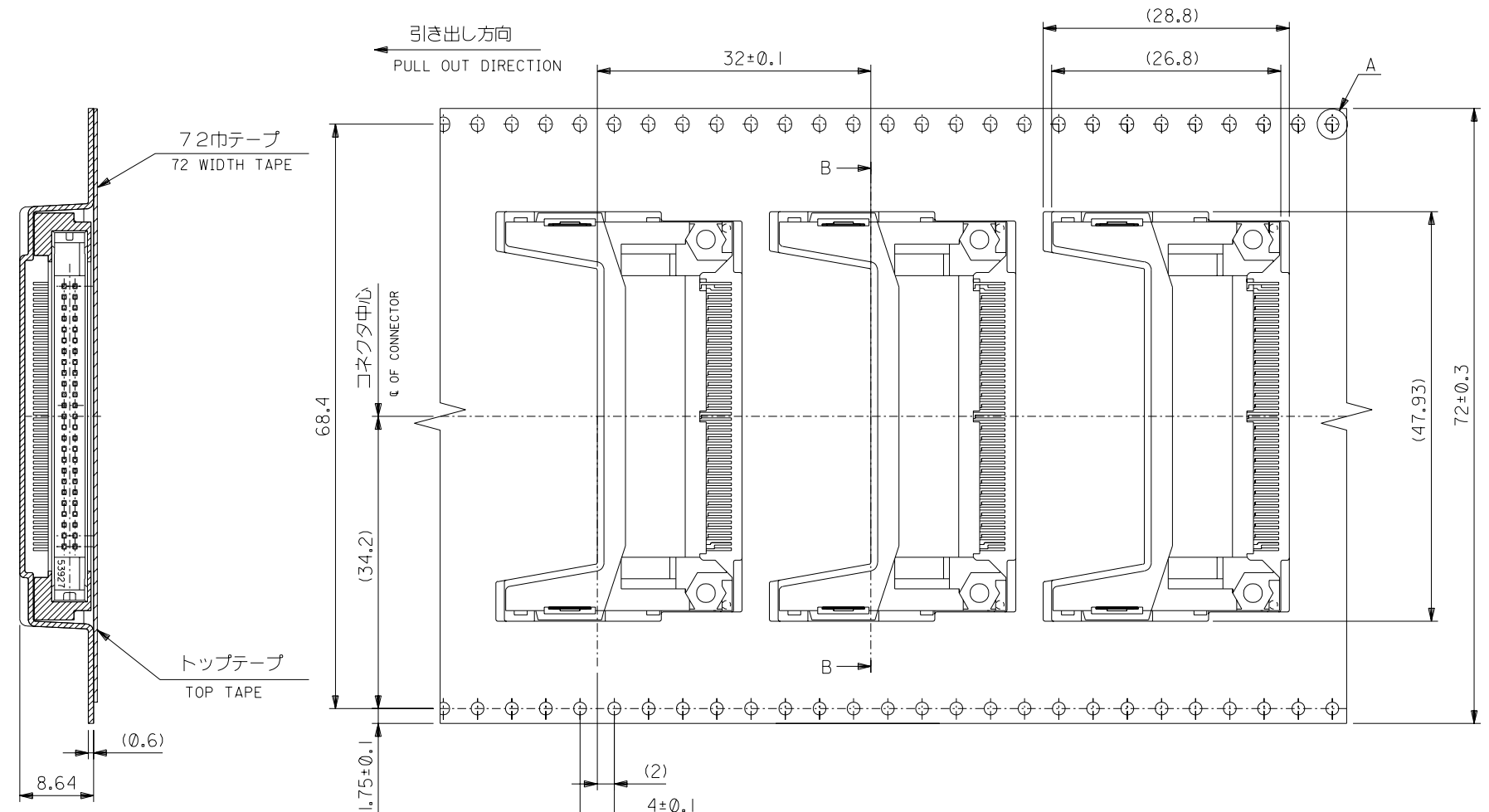
材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		---		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		TITLE 名称 53927-5019 TAPING PACKAGE -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		---		DRAWN BY 04/05/17 CHK'D BY 04/05/17 T.UENO M.SASAO	
DRAWN BY 04/05/17		CHK'D BY 04/05/17		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
APP'D BY 04/05/17		M.SASAO		SD-53927-002 0	
M.SASAO		M.SASAO		SCALE ---	

角度 ANGLE	+30
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

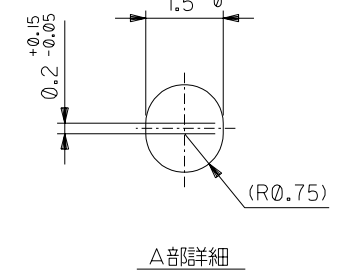
0	新規作成 RELEASED (J2004-4268)	YU	04/05/17
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
		M.S	

DWG. NO.
SD-53927-002

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



断面 B - B
SECTION B-B



累積ピッチ : 40±0.2
ACCUMULATIVE
PITCH : 40±0.2

角度 ANGLE	+30					材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER	+0.3					仕上げ FINISH	—	
10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER	+0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
10 未満 UNDER	+0.2					被覆外径 INS. RANGE	—	53927-5019
一般公差 GENERAL TOLERANCES		SEE SHEET 1 OF 2				DRAWN BY 04/05/17 T.UENO	CHK'D BY 04/05/17 M.SASAO	TAPING PACKAGE
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY 04/05/17 M.SASAO	尺度 SCALE	2 - 1		-LEAD FREE-
								DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)
								SD-53927-002
								REV 0